



台積公司榮獲2021年IEEE企業創新獎

肯定7奈米製程技術領先地位 協助客戶實現多樣化應用創新

發佈單位：台灣積體電路製造股份有限公司

發佈日期：2020年12月9日

台灣積體電路製造股份有限公司今(9)日宣布，榮獲2021年IEEE企業創新獎，該獎項肯定台積公司在7奈米製程技術上的領先地位，協助客戶實現多樣化應用創新。

國際電機電子工程師學會(IEEE)是全球最大的專業技術組織，致力於推動技術發展，以增進人類生活福祉。IEEE於1985年設立企業創新獎，每年表彰在其關注領域中卓越創新的企業、政府或學術組織。2021年IEEE企業創新獎強調台積公司透過其技術上的領先地位及開放創新平台(Open Innovation Platform®)，生產出許多5G行動、具有節能效益與高效能運算優勢的革命性產品，為人類的生活與工作帶來根本的改變。

IEEE主席福田敏男博士表示：「IEEE恭喜台積公司獲得2021年企業創新獎，台積公司在7奈米技術的開發並協助各地晶片設計人員實現創新方面締造了卓越的成就，使其置身於優秀組織的行列，共同為工程領域與全世界做出長遠的貢獻。」

台積公司董事長劉德音博士表示：「台積公司領先的技術結合其專業積體電路製造服務商業模式，體現於台積公司7奈米技術上，其為業界最先進的邏輯製程技術首次以開放平台方式提供給全球半導體產業。我們非常榮幸獲得IEEE這個獎項的肯定，進一步激勵我們持續探索新方法來協助客戶釋放創新。」

台積公司7奈米技術自2018年四月量產以來，已經為數十家客戶的數百種產品生產超過10億顆的良好裸晶(good die)，同時協助晶片設計人員在許多關鍵技術領域推出創新產品，例如人工智慧、數據中心、先進駕駛輔助系統、高效能運算、5G通訊、以及智慧型手機。

為了提供客戶最廣泛且最先進的技術組合，台積公司研發費用占營收比重約8%，2019年研發費用高達美金29億6千萬元，範圍涵蓋了先進邏輯技術、三維積體電路系統整合解決方案、以及特殊製程。憑藉著7奈米平台的成功經驗，台積公司5奈米製程已於2020年順利量產，3奈米製程預計於2022年開始量產。

更多IEEE企業創新獎的相關資訊，請參見：

<https://www.ieee.org/about/awards/recognitions/corporate-innovation.html>



關於台積公司

台積公司成立於 1987 年，率先開創了專業積體電路製造服務之商業模式，自此成為全球規模最大的專業積體電路製造服務公司。台積公司以領先業界的製程技術及設計解決方案組合支援其客戶及夥伴生態系統的蓬勃發展，以此釋放全球半導體產業的創新。身為全球的企業公民，台積公司的營運範圍遍及亞洲、歐洲及北美，致力成為企業社會責任的行動者。

2019 年，台積公司提供最廣泛的先進製程、特殊製程及先進封裝等 272 種製程技術，為 499 個客戶生產 1 萬 761 種不同產品。台積公司為世界首家提供 5 奈米製程技術，即現今最先進的製程技術為客戶生產晶片的專業積體電路製造服務公司。其企業總部位於台灣新竹。進一步資訊請至台積公司網站 <https://www.tsmc.com.tw> 查詢。

#

台積公司發言人：

黃仁昭
副總經理暨財務長
Tel: 03-505-5901

台積公司新聞連絡人：

高孟華
企業公共關係部主管
Tel: 03-563-6688 ext. 712 5036
Mobile: 0988-239-163
E-Mail: nina_kao@tsmc.com

孔培德
企業公共關係部
Tel: 03-563-6688 ext. 712 5031
Mobile: 0988-931-352
E-Mail: pdkramer@tsmc.com